

2015年11月4日

 一般社団法人 組込みシステム技術協会
 株式会社ICSコンベンションデザイン

報道関係者各位

組込み総合技術展 / IoT 総合技術展
「つながる」をテーマにした EDA-LPB パビリオンを新設
主要ベンダによる技術展示と専門セミナーで、EDA 最新情報を発信

一般社団法人 組込みシステム技術協会（JASA）主催、「Embedded Technology 2015（通称：ET2015）」「IoT Technology 2015」（会期：11月18日～20日、会場：パシフィコ横浜）では、本格的なIoT時代を迎え、半導体・基板設計に重要度が高まる EDA 技術にフォーカスした EDA-LPB (Electronic Design Automation-LSI Package Board) パビリオンを新設いたします。

IoT 環境下において、つながるモノは半導体なしではインターネット化ができません。その半導体は、製造工程の自動化を支援する EDA 技術を抜きにしては開発できないのが現状です。

EDA-LPB パビリオンは昨年の EDA ゾーンをさらに発展させ、半導体やプリント基板、電子部品の設計・製造に関わる多彩な EDA ツールと、今年 IEEE2401 として標準化された LSI パッケージボード (LPB) 設計情報とあわせ最新技術や活用シーンを発信、設計者同士やユーザとサプライヤーとをつなぐ場として新設いたします。また、20日(金)には「EDA-LPB トラック」を実施、将来展望や最新トピックスをテーマにした専門セミナーを行い、ET/IoT Technology ならではの情報を提供します。

EDA-LPB パビリオン出展社

アストロン、アンシス・ジャパン、インターバディ、ATE サービス、NTT データ数理システム、オーバートーン、JEITA EDA 技術専門委員会 LSI-Package-Board 相互設計ワーキンググループ、ジェム・デザイン・テクノロジーズ、CM エンジニアリング、図研、TOOL、日本ケイデンス・デザイン・システムズ、日本サーキット、Future Facilities、プロトタイピング・ジャパン、メンター・グラフィックス・ジャパン、WADOW(※50音順)



■ET2015 公式ウェブサイトにて各社の見どころや出展製品・サービスを公開中

新製品 Pick Up !

- ・アストロン CAD ナビゲーションシステム「AZSA」**
 設計データ(GDS II)と故障解析装置(エミッション顕微鏡)、電子顕微鏡(SEM、FIB、プローバー)のリンケージがとれる最新版のシステム。周辺ツールとして CAD や電子顕微鏡像からの3次元解析も可能。
- ・アンシス・ジャパン 電磁界、回路・システム解析ソフトウェア**
 エレクトロニクス製品設計における、シリアル伝送、パワー・インテグリティ、伝導ノイズ、ESD、エミッションとイミュニティなど、電子機器設計における様々な問題に対応するシミュレーション環境を初出展。他、モデルベース統合システム開発環境もあわせて展示！
- ・インターバディ SyDAP model**
 「SyDAP model (サイダップモデル) System Debug Assist Peripheral model」は、システムデバッグを支援する仮想検証向けのマイコン周辺モジュールの SystemC モデル群。SystemC/TLM2.0 に準拠した標準的なインターフェイスであり、既存の仮想検証環境にも容易に組み込むことが可能。かつ機能部は C 言語で実装することで高速動作を実現。

※ 最新の出展社情報はウェブサイトをご覧ください。

■ET2015 EDA-LPB パビリオン 特設ウェブサイトもオープン！

出展社情報やブース内のセミナースケジュールを公開中

>> <http://lpbjpn.org/et2015/>

■ EDA-LPB 専門セミナー開催：SoCをテーマとした基調講演、IoTを見据えたパネルセッション

前回実施した EDAトラックを「EDA-LPBトラック」に改め、LPB フォーマットの動向も対象とした専門トラックとして実施。基調講演、パネルセッションに加え、7 回目となる LPB フォーラムを実施します。

>> <http://www.jasa.or.jp/expo/conf/confpage-eda.html>

11/20(金)13:00~14:45 アネックスホール 2 階 [F201]

第1部 <基調講演>

さらば SoC、されど SoC トランジスタから回路、回路から機能ブロック、
機能ブロックからシステム、システムから？

脇本 康裕 株式会社ソシオネクスト 第三事業本部 コネクテッドイメージング事業部 事業部長

第2部 <パネル討議>

IoT 時代における半導体と EDA の進むべき道 爆発的なビジネス拡大に備えよ、
その道で本当に大丈夫ですか！？

モデレーター：津田 建二 株式会社セミコンダクタポータル 編集長

11/20(金)15:00~16:45 アネックスホール 2 階 [F201]

第 7 回 LPB フォーラム

第 1 部 LSI パッケージボード設計標準フォーマット IEEE2401-2015 制定発表

第 2 部 座談会 IEEE2401-2015 で広がる機器設計の情報流通

福場 義憲 一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体部会 EDA 技術専門委員会
LSI パッケージボード相互設計ワーキンググループ 主査

※ ご来場の際は、公式ウェブサイトにて、来場事前登録を行ってください。

----- 開催概要 -----

Embedded Technology 2015 / IoT Technology 2015 2015 年 11 月 18 日(水)~20 日(金)@パシフィコ横浜

主催：一般社団法人 組込みシステム技術協会 / 企画・推進：株式会社 ICS コンベンションデザイン

■ニュースリリースに関する報道関係者からの問い合わせ先

Embedded Technology プロモーション担当/株式会社ピーアンドピービューローウ

TEL.03-3261-8981 guidebook@et-guide.com [担当] 樋口

■本展に関する一般の方からの問い合わせ先

Embedded Technology 事務局(株式会社 ICS コンベンションデザイン) 内山/山口

TEL.03-3219-3648 etinfo@jasa.or.jp